

フレックスリジッド基板

Flex-Rigid Printed Circuit Board

特長 Features

- ✓ 試作～小ロット生産：本社工場およびベトナム工場
Sample-Small Volume Production : Headquarters Factory, Sample-Volume Production Vietnam Factory
- ✓ 貫通およびビルドアップ構造対応可能
Correspondence of PTH and build-up Layer

用途 Application

車載
Automotive

モバイルフォン
Mobile phone

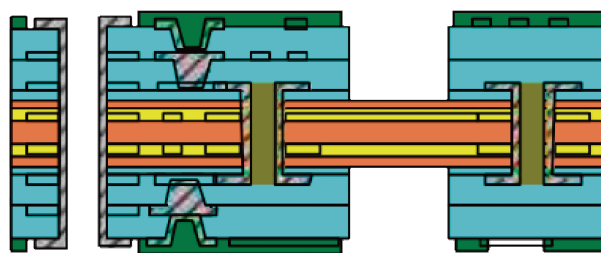
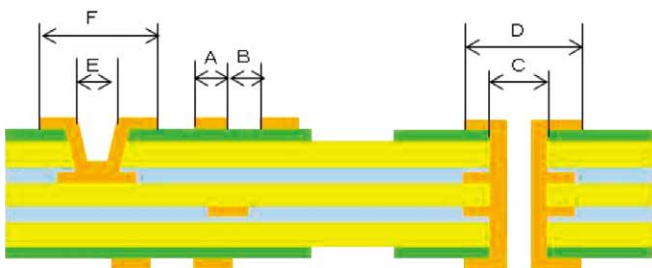
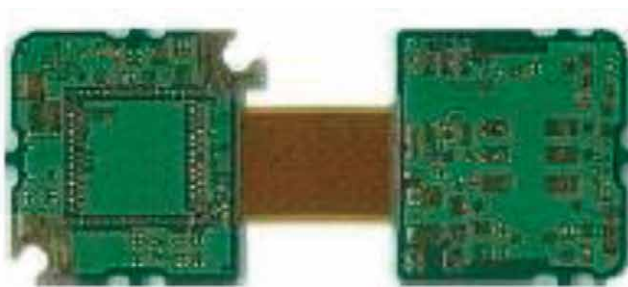
カメラモジュール
Camera Module

FPCコネクタ不要

組立て工数の削減

実装面積削減

振動に対する信頼性高い



8層(2-4-2)までのビルドアップ構造可能

		メーカー対応仕様
A	最小パターン幅(リジッド層)	0.075mm
	最小パターン幅(フレキシ層)	0.050mm
B	最小スペース幅(リジッド層)	0.075mm
	最小スペース幅(フレキシ層)	0.050mm
C	最小ドリル径	φ0.2mm
D	最小スルーホールランド径	φ0.450mm
E	最小レーザービア径	φ0.100mm
F	最小レーザービアランド径	φ0.250mm

フライングテール構造可

インピーダンスコントロール可

スキップビア(開発中)